



东莞市凌讯电子有限公司

Dongguan Lingxun Electronics co.,Ltd

SBT30L45DC 封测规范

文件编号:K0056-SBT30L45DC-263-ADC-0

版本	变更描述	工程变更单号	生效日期
A0	新增		2018-9-28

1. 芯片及晶圆规格

晶圆品名	CPA0U045HL	晶圆直径	152.4mm (6")
芯片尺寸 (不含划片槽)	2.54mm*2.54mm (100mil)	中测	墨点
键合区尺寸	2.395mm*2.395mm	划片尺寸	60μm
芯片正面金属及厚度	铝	芯片背面金属	银

2. 封测流程和材料清单 (BOM)

2.1 封测流程

封装形式	T0-263	装片工艺	锡丝
焊线	20mil 铝线 2 根 (软铝丝)	前热烘	/
塑封料	ROHS 环氧树脂	后固化	温度: 170°C, 时间: 8 小时
电镀	雾锡 (纯锡), 镀层厚度大于 5um	切筋	需要
电性测试	DC 电性+浪涌	打印	激光打印
包装	管 /50 颗		

2.2 材料清单 (BOM)

描述	类型	规格	用量	供应商
芯片		2.54mm*2.54mm	2	
框架	T0-263	T0263HW-LX	1	港波/荣科
焊料	锡丝	Pb:Sn:Ag = 92.5:5:2.5	3.4mm	雪浪
键合丝	软铝丝	20mil/2 根	1.34cm	贺利氏/莱克雷
塑封料	ROHS	KH-9200-2/WH-1100M-t Φ48mm*75g	0.9375g	科化/创达
电镀	雾锡 (纯锡)	镀层厚度大于 5um, 镀层锡含量大于 99.9%		
包装	防静电胶管	50 颗一管	1	华印/菱丰

2.3 芯片示意图和键合配线方案

	<p>DIE:2 20mil/2 根 (软铝丝)</p>
---	----------------------------------



东莞市凌讯电子有限公司

Dongguan Lingxun Electronics co.,Ltd

SBT30L45DC 封测规范

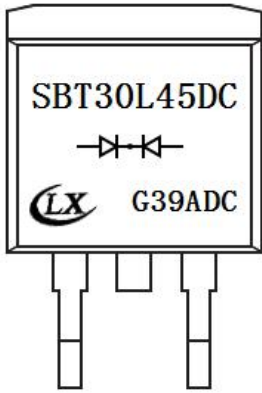
文件编号:K0056-SBT30L45DC-263-ADC-0

3. 测试程序

项目	参数	测试条件	成测		检测		单位
			最小	最大	最小	最大	
1	IEB	VEB=10v	-	100	-	100	μA
2	反向浪涌	at I _R =1A	45	80	45	-	V
3	ΔV _F	at I _m =10mA, ΔI _F =60 A, PW=75ms		待定			mV
4	V _{BR}	at I _R =0.3mA	47	80	45	-	V
5	V _{F1}	at I _F =15A	0.45	0.51	-	0.53	V
6	V _{F2}	at I _F =15A	0.45	0.51	-	0.53	V
7	DV _F	V _{F2} - V _{F1}	-0.01	0.01	-0.03	0.03	V
8	I _R	at V _R =45V	10	50	-	130	μA

4. 打印规范

印章示意图

	<ol style="list-style-type: none"> 1. 第一行打印产品型号: SBT30L45DC (固定不变); 2. 第二行打印极性符号 (固定不变); 3. 第三行左下角打印公司 LOGO (固定不变); 4. 第三行右下角打印内容: G39ADC, 第 1 位字母代表年份:2012 年为 A...2017 年为 F, 2018 年为 G; 第 2、3 位为数字, 代表生产的周期, 39 指第 39 周 (此项可变更); 第 4 位为字母, A 代表 ROHS, H 代表无卤; 第 5、6 位字母 DC 为内部代码。 5. 第一行与第三行左右均对齐, 第二行居中打印。
---	---

5. 包装信息(中性包装)

1000pcs/盒, 5000pcs/箱.

部门	工艺工程部	品质部	生产部	物控部	体系管理	总经办
审核		胡春彬	张工、李工	胡青艳	黄小姐	周总